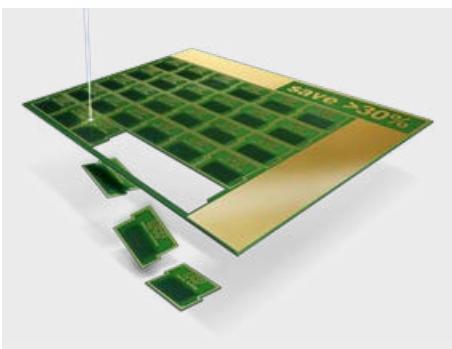
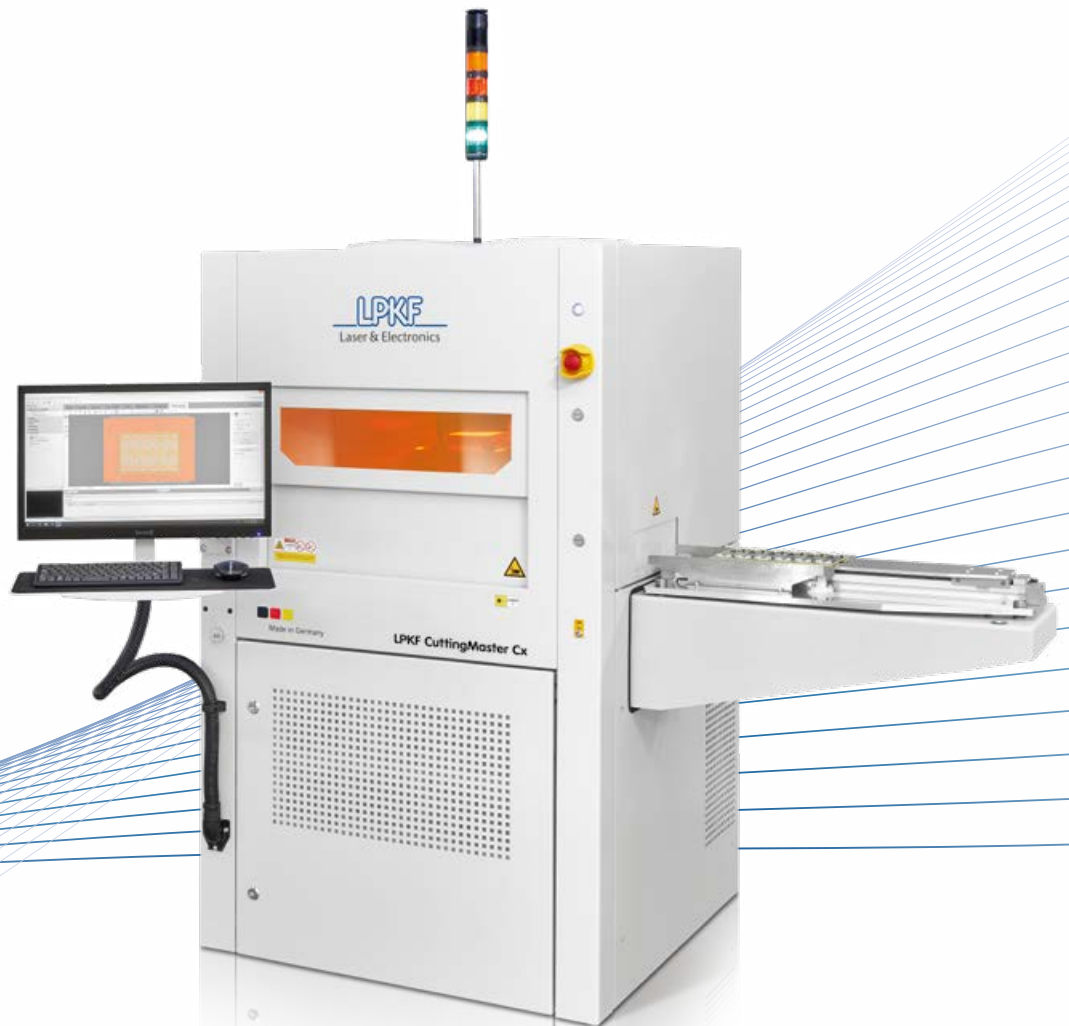


Hochautomatisiertes Laser-Nutzentrennen für maximale Performance LPKF CuttingMaster 2000 Cx

- Zuverlässiges und wirtschaftliches Nutzentrennen von Leiterplatten
- Kompakte und kosteneffiziente Automatisierungslösung
- Keine rotierenden Werkstückträger erforderlich
- Einfache Integration in Produktionslinien



Kosten-effiziente Automatisierung für's Laser-Nutzentrennen – LPKF CuttingMaster 2000 Cx

Lasernutzentrennen vom Feinsten: Konsequente Anlagenoptimierungen für noch mehr Wirtschaftlichkeit. Der LPKF CuttingMaster 2000 Cx ist speziell für das Nutzentrennen von starren Leiterplatten in großen Mengen konzipiert. Er funktioniert eigenständig oder integriert in Produktionslinien. Ein Highlight ist eine neue integrierte Automatisierungslösung, die umlaufende Werkstückträger überflüssig macht.

Kostengünstige Automatisierungslösung

Dank ausgefeilter Funktionalität und einem kompakten Design ist der LPKF CuttingMaster Cx eine kostengünstige und attraktive Lösung für automatisiertes Laser-Nutzentrennen. Die integrierte Klemmvorrichtung und eine produktspezifische Gabel zum Halten und Entladen machen rotierende Werkstückträger überflüssig.

Flexible Automatisierung

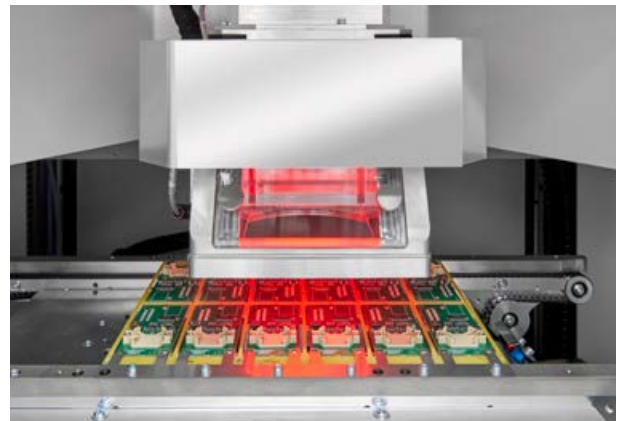
Zusätzlich kann zum Beispiel ein Roboter installiert werden, um die getrennten Leiterplatten und den verbleibenden Rahmen zu entladen. Dank der SMEMA- und OPC UA-Schnittstellen können auch Automatisierungslösungen von Drittanbietern flexibel ergänzt werden.

Leistungsstarke Software LPKF CircuitPro

Die intuitive Systemsoftware LPKF CircuitPro generiert aus den Layoutdaten optimale Prozessparameter. So entstehen produkt-spezifische Prozessdaten für optimale Schneidqualität und -performance. In kürzester Zeit können auf diese Weise bestehende Applikationen angepasst oder neue Vorhaben erstellt werden.

Optimierung der Höchstleistung

Durch die clevere und zuverlässige Hardware, die einfach zu bedienende Software und die Integration standardisierter Schnittstellen sorgt der LPKF CuttingMaster Cx für eine weitere Verbesserung der 2000er-Serie. Er verwendet eine leistungsstarke Laserquelle und die fortschrittliche Tensor-Technologie zum Nutzentrennen von Leiterplatten für Voll- oder Stegschnitte.



LPKF CuttingMaster 2000 Cx

Max. Arbeitsbereich (X x Y)	350 mm x 250 mm
Positionsgenauigkeit	± 25 µm
Durchmesser des fokussierten Laserstrahls	~20 µm
Systemabmessungen (B x H x T)	1600 mm x 2180 mm x 1140 mm*
Gewicht	~ 500 kg
Optionale Features	OPC UA Standard-Schnittstelle, Performance Absaugkopf, Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV)

Laserleistung	Wellenlänge	Pulsdauer	Systemvariante
40 W	532 nm	Nanosekunde	2240

* Höhe inklusive Statusampel

